

# OBSAH

Předmluva . . . . .	11
Seznam použitých symbolů . . . . .	14
1. Úvod . . . . .	17
2. Fyzika častic a fenomenologie sdílení tepla . . . . .	20
2.1. Měrná tepelná vodivost a kapacita pevné látky . . . . .	20
2.1.1. Fononová vodivost . . . . .	20
2.1.2. Elektronová tepelná vodivost . . . . .	21
2.1.3. Měrná tepelná kapacita pevné látky . . . . .	21
2.1.4. Měrná tepelná vodivost plynů . . . . .	22
2.2. Sdílení tepla konvekcí a zářením . . . . .	23
2.2.1. Konvekce a sdílení tepla . . . . .	23
2.2.2. Záření a sdílení tepla . . . . .	24
2.3. Fenomenologická teorie vedení tepla . . . . .	25
2.3.1. Veličiny a pojmy fenomenologického popisu vedení tepla . .	25
2.3.2. Vedení tepla v izotropní pevné látce a Fourierův zákon . .	28
2.3.3. Formulace Fourierovy diferenciální rovnice vedení tepla v pevné látce . . . . .	29
2.3.4. Okrajové podmínky . . . . .	31
2.3.5. Některé problémy související s okrajovými podmínkami . .	33
2.3.6. Bezrozměrné parametry v rovnicích . . . . .	36
2.3.7. Zjednodušení problému vedení tepla pro případ okrajových podmínek nezávislých na čase . . . . .	37
2.3.8. Laplaceova rovnice a ustálené rozložení teploty v objektu .	38
3. Modelování sdílení tepla v konstrukcích elektroniky . . . . .	39
3.1. Konstrukční model sdílení tepla . . . . .	40
3.2. Hledisko fyziky v modelování sdílení tepla . . . . .	41
3.3. Hledisko matematiky v modelování sdílení tepla . . . . .	43
3.4. Hledisko kybernetiky v modelování sdílení tepla . . . . .	43
3.5. Obvody se soustředěnými parametry a modelování sdílení tepla . . . . .	46

3.6.	Statistika a konstrukční modelování sdílení tepla	46
4.	Některá řešení jednoduchých okrajových úloh Fourierovy rovnice vedení tepla	48
4.1.	Řešení Fourierovy rovnice pro prostor, který je vyplněn pevnou látkou a ohraničen dvěma rovnoběžnými rovinami s konečnou distancí	48
4.1.1.	Řešení okrajových úloh pro vrstvu pevné látky při počáteční teplotě konstantní nebo nulové	50
4.1.2.	Řešení okrajové úlohy pro vrstvu pevné látky při nulové počáteční teplotě. Odezva výstupního tepelně izolovaného rozhraní na skok teploty na vstupním rozhraní	51
4.1.3.	Tyč konečné délky	54
4.1.4.	Řešení Fourierovy rovnice pro poloprostor vyplněný pevnou látkou	54
4.1.5.	Řešení pro poloprostor a impuls	57
4.2.	Řešení okrajové úlohy Fourierovy rovnice vedení tepla pro vrstvu pevné látky v integrálním zobrazení	59
4.2.1.	Řešení v Laplaceově integrálním zobrazení	59
4.2.2.	Neohraničená rovinná vrstva pevné látky konečné tloušťky	60
4.3.	L-operátorový přenos objektu a teplotní přechodová charakteristika	62
4.3.1.	Platnost součinu $v(p) = w(p) \cdot S(p)$ pro kompaktní objekt na základě principu superpozice	67
4.4.	F-operátorový přenos objektu a teplotní frekvenční charakteristika	70
4.4.1.	F-operátorový přenos objektu	70
4.4.2.	Frekvenční charakteristiky objektu	71
4.4.3.	Objekt jako teplotní frekvenční filtr	72
4.5.	Diferenční matematické modely odvozené z parciálních diferenciálních rovnic	73
4.5.1.	Systém obyčejných diferenciálních rovnic jako dynamický model odpovídající Fourierově parciální diferenciální rovnici	73
4.5.2.	Tvoření druhých diferenčních poměrů vzhledem k prostorovým proměnným. Algebraický lineární systém pro Laplaceovu rovnici	75
4.5.3.	Diferenční matematický model odpovídající Fourierově rovnici (dynamický model)	81
4.5.4.	Diferenční matematický model odpovídající Laplaceově rovnici (statický model)	86
5.	Modely o konečném počtu prvků. Diskretizace spojité úlohy vedoucí na náhradní systémy se soustředěnými parametry	88

5.1.	Formulace náhradních tepelných obvodů . . . . .	88
5.1.1.	Zvláštnosti problému modelování sdílení tepla v konstrukcích elektroniky . . . . .	88
5.1.2.	Termofyzikální vlastnosti kompaktního hmotného prostorového útvaru . . . . .	89
5.1.3.	Fiktivní dělení objektu na prostorové sekce. Přiřazení náhradních uzlů a náhradních obvodových prvků sekčím . . . . .	89
5.1.4.	Formulace tepelného náhradního obvodu a systému $n$ rovnic pro $n$ sekci objektu. Systémy obyčejných diferenciálních rovnic . . . . .	93
5.1.5.	Sestavení náhradního odporového obvodu – statického modelu vedení tepla v objektu . . . . .	96
5.2.	Problém správnosti náhradního tepelného obvodu se soustředěnými tepelnými odpory a kapacitami . . . . .	98
5.2.1.	Obvodová interpretace při odvozování Fourierovy parciální diferenciální rovnice. Fyzikální absurdita náhradního obvodu se soustředěnými tepelnými odpory a kapacitami . . . . .	98
5.2.2.	Historie řetězcových elektrických obvodových modelů vedení tepla . . . . .	100
5.2.3.	Náhradní tepelný obvod s tepelnými odpory a tepelnými kapacitami odpovídajícími sekčím stejnomořně děleného objektu. Řešení náhradního obvodu a řešení Fourierovy rovnice . . . . .	102
5.3.	Dynamické vlastnosti série $n$ stejných přenosových bloků . . . . .	113
5.4.	Bloková schémata s bloky charakterizovanými L-operátorovými přenosy. Souvislost se strukturou sekcí nebo sestavy a s prvkovými náhradními obvody se soustředěnými parametry . . . . .	116
5.5.	Optimální náhradní dvoukapacitní tepelné obvody pro jednorozměrné vedení tepla vrstvou pevné látky ve směru kolmém k jejím rovinám . . . . .	121
6.	Modely o několika prvcích – zjednodušené náhradní tepelné obvody $WC$ . . . . .	126
6.1.	Formulace jednoduchých tepelných náhradních obvodů . . . . .	126
6.1.1.	Jednoduché náhradní prvkové obvody a jejich užitečnost . . . . .	126
6.1.2.	Jednoduché náhradní obvody formulované pro skutečnou strukturu konstrukce . . . . .	127
6.1.3.	Náhradní schémata s přenosem ve tvaru racionální lomené funkce. Heavisideův rozklad přenosu . . . . .	128
6.2.	Náhradní schéma objektu, získané rozkladem přesného přenosu, jako nekonečná série přenosových bloků bez vztahu ke struktuře objektu . . . . .	130
7.	Modely o jednom obvodovém prvku a jedné smyčce . . . . .	135

7.1.	Statický jednoprvkový model reprezentovaný tepelným odporem	136
7.2.	Nejjednodušší tepelný dynamický model objektu, náhradní obvod s jednou smyčkou $WC$	139
7.2.1.	Formulace a tvary náhradního modelu 1. řádu	139
7.2.2.	Řešení impulsového zatěžování pomocí modelu 1. řádu	141
7.2.3.	Přímkový grafický model 1. řádu	147
8.	Identifikace dynamických modelů sdílení tepla	149
8.1.	Identifikace jako etapa modelování jevu	149
8.2.	Identifikace podle přechodové charakteristiky objektu	150
8.3.	Identifikace podle frekvenční charakteristiky objektu	152
8.4.	Identifikace k určení materiálové konstanty $\kappa$	155
9.	Fyzické modely sdílení tepla	156
9.1.	Analogie různých fyzikálních jevů a teorií	156
9.2.	Spojitý elektrický analogon pro integraci Laplaceovy rovnice	157
9.3.	Diskrétní elektrický analogon pro integraci Laplaceovy rovnice. Odporová síť	159
9.4.	Diskrétní elektrické analogony $RC$	160
9.4.1.	Přímé elektrické diskrétní analogony	160
9.4.2.	Diskrétní nepřímé elektrické analogony s operačními zesilovači	162
9.5.	Podobné modely	164
9.5.1.	Nástin klasické teorie podobnosti	164
10.	Laboratorní praxe modelování sdílení tepla v konstrukčním výzkumu elektroniky	168
10.1.	Předmět experimentu. Typické problémy a směry vývoje	168
10.2.	Práce se vzorky a modely v laboratoři	169
10.3.	Měření termických veličin pro modelování	170
10.3.1.	Měření oteplení a teploty mikrotermočlánky	171
10.3.2.	Měření měrné tepelné vodivosti v laboratorních podmínkách	175
10.3.3.	Použití teplotní přechodové charakteristiky vrstvy k stanovení teplotní vodivosti jejího materiálu	178
11.	Konstrukční modelování sdílení tepla v praxi a některé provedené jednoduché modely. Stav a směry vývoje	184
11.1.	Konstrukce v elektronice a jejich vztah k modelování sdílení tepla	186
11.2.	Ukázky modelů a modelových řešení	190
11.2.1.	Statický model oteplení a výkonové zatižitelnosti hybridní desetičkové integrované součástky	190
11.2.2.	Statický model oteplení rezistoru	192

11.2.3.	Dynamický model 1. řádu oteplování rezistoru. Přímkový diagram oteplování rezistoru	197
11.2.4.	Modelové řešení zatěžování vrstvového rezistoru pravoúhlými periodickými impulsy výkonu pomocí modelu 1. řádu	201
11.2.5.	Dynamický model 2. řádu pro řešení oteplování bodu na vrstvovém zdroji tepla	205
11.2.6.	Modelové řešení zkušebních periodických impulsů výkonu pomocí nekaskádního modelu 2. řádu	208
	Literatura	212
	Tabulky	222
<b>Matematické přílohy</b>		
duševní práce	Summary	240
řešené teplotní		
kvalitu a sítě	Резюме	241
modelů		
Index	Rejstřík	242

Modelování tepelně technických problémů má svou historii, která se objevuje především v literatuře. Tam také lze sledovat znakovou univerzalitu této metodiky. K modelování se přistupuje nekdy vcelku obecně jako k metodologickému problému poznání vědy i praxe. Modelování je ovšem především využíváno jako jednou z metod výzkumu. V posledních letech je rozšířen výrazněji modelování, které byl využíván včetně výpočtu a výpočetní techniky. Modeluje se ve fyziologii, v technice, biologii, ekologii, sociologii a metodika proniká do dalších oblastí.

Pro současnou dostupnost a výkonnost technických prostředků modelování se často ztrácí bezprostřední souvislost modelů s modelovanými jevy. Neřeší se mnohdy problém zobrazení. Nerozlijuje se přesnost a správnost zobrazení. Proto jedním z hlavních témat této práce je výjasnit pojem správnosti zobrazení. Autor snaží se důvod k tomu také ve skutečnosti, že modely jsou považovány pojmány buď jako problémy matematiky a numerické matematiky, nebo teorie obvodů a teorie systémů, bez teoreticky podloženého vztahu k realitě problému. Pak modely, byť i ve své vědní disciplině dobře propracované, nemusí být nějak správným zobrazením problému.

Po druhé světové válce se velmi rychle rozvíjela teoretická a experimentální práce v oboru sdílení tepla a termofyzikálních vlastností látek a bylo publikováno i mnoho prací. Avšak v tomto nadbytku dílčích prací není patrná vědecká kooperace, která by byla podřízena nějaké koncepci, ať už technického nebo poznávacího zaměření. Zjevně naopak je, že mnohá zařízení, v nichž je sdílení tepla, zejména nestacionární, pro funkci důležité, nejsou navržena dobře. Nahledneme-li do základní vývoje, zjistíme, že takové výrobky nebyly navrhovány žádoucí racionální a tím méně inženýrskou nebo vědeckou metodou. V této souvislosti se může mluvit o stavbách a vytápění, o kotlích a jiných energetic-